

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，将公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 340 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 2,500,000.00 元后的余款人民币 337,500,000.00 元由主承销商东吴证券于 2022 年 12 月 22 日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计 918,867.92 元，本次实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00178 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投

入募投项目 242,759,048.93 元，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集资金余额为 70,885,662.68 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 8,285,662.68 元存放于募集资金账户，6,260 万元进行现金管理。

（2）本年度使用金额及当前余额

本年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目 17,805,693.13 元。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	336,581,132.08
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	32,703,627.54
减：募投项目支出	260,564,742.06
其中：前期累计使用募集资金	242,759,048.93
本期使用募集资金	17,805,693.13
加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额	10,186,432.04
减：永久补充流动资金	39,891,997.22
募集资金余额	13,607,197.30
其中：用于现金管理的余额	11,500,000.00
募集资金专户余额	2,107,197.30

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为 13,607,197.30 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 2,107,197.30 元存放于募集资金账户，1,150 万元进行现金管理（银行通知存款，非银行理财产品）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上[2025]480 号）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

（一）募集资金管理情况

2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	项目	初始存放金额	2026 年 6 月 30 日余额
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902502010505	半导体设备等 领域精密金属	80,000,000.00	2,107,197.30
中信银行股份有限公司苏州分行营业部	8112001013000701648	部件智能化生 产新建项目	257,500,000.00	11,500,000.00
合计	/	/	337,500,000.00	13,607,197.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年半年度募投项目的资金使用情况详见本报告“附表 1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026 年半年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2026 年半年度，本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营

和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过 6,000 万元闲置募集资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2026 年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益为 1,018.64 万元。截至 2026 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。尚在进行现金管理的为银行通知存款。

（六）节余募集资金使用情况

2026 年半年度，公司使用节余募集资金 39,891,997.22 元永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为 13,607,197.30 元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 2,107,197.30 元存放于募集资金账户，1,150 万元进行现金管理（银行通知存款，非银行理财产品）。

（九）募集资金其他使用情况

2026 年半年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司 2026 年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1

2026 年半年度募集资金使用情况对照表（2022 年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额（注）			33,658.11			本年度投入募集资金总额		1,780.57		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	29,326.84			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目（含 部分变更）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额（1）	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额（2）	截 至 期 末 投 资 进 度（%）（3）= （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目	否	33,658.11	33,658.11	1,780.57	29,326.84	87.13	2026 年 6 月	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,658.11	33,658.11	1,780.57	29,326.84	87.13	/	/	/	/
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目” 基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。为严格把控募投项目的实施质量，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，基于审慎原则，公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过将预计可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日前调整为 2025 年 6 月 30 日前；2025									

	年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过将该项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日。 截至 2026 年 6 月 30 日，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”整体已达到预定可使用状态。由于可转债募投项目于 2026 年 6 月 10 日结项，截至 6 月 30 日投入生产时间尚短，尚未产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 1 月，经公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 33,128,155.84 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 32,703,627.54 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 424,528.30 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。 同时，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。截至报告期末，剩余未投入募投项目的 5,349.92 万元将用于全部补流。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司第四届董事会第四次会议决议、2026 年第二次临时股东会决议，公司已对可转债募投项目结项，并将募集资金专户节余资金（含利息及理财收入）全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金，支持公司日常经营及业务发展。截至报告期末，未投入募投项目的 5,349.92 万元，其中，已经有 3,989.20 万元用于永久补流，余额 1,360.72 万元后续继续用于永久补流。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

